

EV GROUP joins hands with ITRI to expand advanced heterogeneous integration process development – August 31, 2022

微機電系統 (MEMS)、奈米科技與半導體市場的晶圓接合暨微影技術設備廠商 EV Group (EVG)，
8/31 宣布攜手工研院擴大先進異質整合製程的開發。

在半導體製造中，隨著超越電晶體微縮的更高效能需求提升，3D 垂直堆疊與將多種不同的組件與晶粒，從製造、組裝到封裝至單一設備或封裝中的異質整合封裝技術，也促成了高頻寬互連，以提升整體系統的效能，更成為 AI 人工智慧、自動駕駛與其它高效能運算應用的關鍵驅動力。

經濟部積極推動「人工智慧晶片異質整合模組前瞻製造平台」及「可程式化異質 3D 整合」等國家級的研發專案，並支持工研院成立異質整合小晶片系統封裝聯盟 (Heterogeneous Integration Chip-let System Package Alliance, Hi-CHIP)，協助打造包括封裝設計、測試與驗證，及試產生產的完整生態系，已逐步達成供應鏈在地化的目標，更成功擴展商機。

由於 EVG 是 Hi-CHIP 聯盟成員之一，多套 EVG 最先進的晶圓接合與微影系統，包括 LITHOSCALE 無光罩曝光微影系統、EVG 850 DB 自動化剝離系統及 GEMINI FB 混合接合系統將於 2022 年底前進駐工研院 3D-IC 實驗室。未來將工研院的先進設備導入量產平台後，將協助雙方的共同客戶加速開發全新異質整合製程，拓展至客戶端的晶圓廠。

工研院電子與光電系統研究所副所長駱韋仲表示，工研院的使命為帶動工業發展、創造經濟價值並透過科技的研發增進社會福祉，長期以來持續開發全新 3D 與異質晶片整合製程，並為供應鏈打造更緊密的合作關係，推進半導體產業持續發展與成長。由於工研院的全自動化量產系統與合作業者的晶圓廠規格相同，包括來自 EVG 的全新晶圓接合與微影解決方案，有利於業者立即將工研院開發的製程配方導入生產過程，加速從實驗室到晶圓廠量產上市時程。

EV Group 執行董事會成員暨銷售與客戶支援執行總監 Hermann Wlatl 表示，EVG 自 1980 年在奧地利成立以來，秉持發明 (invent)、創新 (innovate)、實作 (implement) 「3I」理念，積極與工研院等全球領先的研究機構合作，加速推動半導體產業未來創新的新技術開發與商業化。EVG 目前在全臺皆有優秀的製程與應用工程團隊，過去幾年來已大幅擴展製程相關基礎架構，未來雙方在持續合作下，除了讓 EVG 取得世界級的研究專業知識，更能進一步強化 EVG 在台灣的製程優勢，滿足在台客戶與合作業者逐步增加的需求與挑戰。

<https://technews.tw/2022/08/31/ev-group/>